



2021年10月20日

各位

会社名 株式会社ディー・ディー・エス
代表者 代表取締役会長 三吉野 健滋
(東証マザーズ・コード番号 3782)
問合せ先 経営管理部 部長 小野寺 光広
電話番号 052-955-5720
(URL <https://www.dds.co.jp/ja/>)

汗孔と隆線を使った認証アルゴリズムに関する米国における
新特許の権利化完了についてのお知らせ

指紋認証を始めとした様々なセキュリティ・ソリューションを提供する株式会社ディー・ディー・エス（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：久保 統義、以下 DDS）は、汗孔と隆線を使った認証アルゴリズムに関する特許出願について、米国において権利化が完了しましたので、お知らせいたします。なお、本特許は日本国内においても権利化されております。

【発明の名称】 認証情報処理プログラム及び認証情報処理装置

Authentication information processing method, authentication information processing device, and non-transitory computer-readable medium

【特許権者】 DDS, Inc.

【出願番号】 16/678348

【特許番号】 11106890

本特許は、汗孔（かんこう）（*1）などの指紋の隆線の微細構造を解析することで認証を行う高精度の認証アルゴリズムを実現しました。汗孔をはじめとする微細構造は、従来多く利用されてきた隆線の分岐点や端点などと呼ばれる指紋の特徴点と比べ、非常に多く存在します。小さな面積のセンサーであっても、高解像度で撮影し、微細構造を抽出することで、高精度で認識を行うことができます。

◆用語の解説

*1 汗孔（かんこう）：汗が排出される出口のこと。

※参考

【日本特許番号】 特許第6879524号

【登録日】 2021年5月7日

なお、当発表においてDDSの2021年12月期の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上